

2024年11月25日

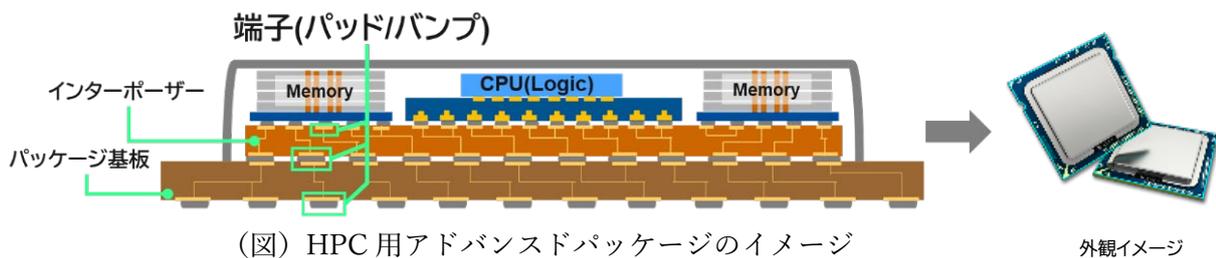
会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

業界初、アドバンスドパッケージ用テスター「LIBRA」の受注を開始

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F）の100%出資子会社であるオー・エイチ・ティー株式会社（本社：広島県福山市神辺町字西中条1118番地の1 代表取締役社長 羽森 寛、以下OHT社）は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)用アドバンスドパッケージを検査する「LIBRA」の1号機を受注いたしましたので、ご案内いたします。

<背景>

高速・低遅延で大容量のデータ処理を支えるHPC用半導体においては、数多くのCPUやHBMメモリーがインターポーザ基板を介して最も効率的に配置、接続され、一つのシステムとして生成AI用サーバー等へ搭載されます。その為、個々の半導体に加えインターポーザ等に対しても高水準の品質管理が求められています。



(図) HPC用アドバンスドパッケージのイメージ

外観イメージ

<半導体テスター「LIBRA」>

LIBRAは、従来方式の検査で対応が不可能なほどに狭ピッチ化が急速にすすむパッケージ基板・インターポーザ(RDL)上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現しました。

この装置は、配線層を積層する途中工程から完成後の最終検査までに必要とされる多種多様な検査に、当社グループの独自技術を結集して開発した超微細 μ プローブを採用、量産ラインへの適用が見込まれる $25\mu\text{m}$ ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応しています。

更に、端子部への接触が物理的に困難な配線については、OHT社と東北大学が共同開発した非接触センサーを採用することで多岐にわたる電気検査を実現しております。

<今後の展開について>

HBM(High Bandwidth Memory、広帯域メモリー)の歩留まり向上が期待できるメモリーダイの積層前検査技術の開発にも積極的に取り組んでまいります。

ブイ・テクノロジーグループは、半導体やディスプレイ等の電子デバイスの多様な進化を支える革新的な技術の開発に注力していくとともに、大きいなる志と溢れる情熱で世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献してまいります。

以上